

加利福尼亞微設備公司將在斯科茨代爾舉行的國際微電子研討會上展示晶圓級晶片規模封裝技術論文並舉行小組討論
加利福尼亞微設備公司將在國際微電子研討會上發表關於新的再鈍化技術的論文，作為此次論壇項目的一部分

亞洲網亞利桑那州斯科茨代爾 3 月 19 日電 加利福尼亞微設備公司 (CMD) 宣布，公司將在 2008 年 3 月 17 日到 20 日于亞裏桑那州斯科茨代爾的 Radisson Fort McDowell Resort and Casino 舉行的國際微電子研討會 (IMAPS) 第四屆設備封裝國際會議和展覽會上發佈關於新的晶片級封裝 (CSP) 再鈍化技術的論文，這種技術旨在將專用集成無源設備 (ASIP(TM)) 產品中的無源元件數量減到最少。該論文將是晶圓級晶片規模封裝論壇 (WLCSP Forum) 發起的研究晶圓級晶片規模封裝板耐用性的論文的一部分。

新的 CSP 製造技術改善了 ASIP 的性能和耐用性

論文的題目為《將 ASIP 產品中無源元件數量減到最少的新的再鈍化/漏電斷路晶片級封裝 (RDL CSP) 技術》，闡述了 WLCSP 技術中無源電容的作用，為 WLCSP 提供了優化的再鈍化和 RDL 技術，以提高基於 CSP 的靜電釋放 (ESD) 保護產品和電磁干擾 (EMI) 篩檢程式的電子性能，並提高熱機械耐用性。該論文將由 CMD 公司鑄造工程和業務總監 Umesh Sharma 博士闡述。會議之後，可以從公司網站下載該論文，網址：

[http://www.cmd.com/applications/papers.](http://www.cmd.com/applications/papers.php)

[php](http://www.wlcspforum.org), 或者訪問晶圓級晶片規模論壇網站，網址：<http://www.wlcspforum.org>。

關於 WLCSP 耐用性的小組討論

在 IMAPS 設備封裝會議期間，WLCSP 論壇將組織兩場關於 WLCSP 主板耐用性的小組討論。第一次討論的時間是 3 月 18 日，將闡述 CMD 公司新的再鈍化和 RDL CSP 技術以及其他 4 篇由 WLCSP 論壇成員撰寫的技術論文。小組論壇將由 CMD 公司行銷副總裁許勒·貝克 (Kyle Baker) 和 WLCSP 論壇主席共同主持。

關於加利福尼亞微設備公司

加利福尼亞微設備公司是一家為移動手持設備、數位消費電子產品和個人計算機市場提供專用類比及混合信號半導體產品的領先供應商。主要產品包括用於移動手持設備、數位消費電子產品，如數位電視和個人電腦的保護裝置，以及用於移動手持設備顯示器的類比及混合信號積體電路。欲查詢公司及產品詳情，

請訪問：<http://www.cmd.com>。

ASIP 是加利福尼亞微設備公司的商標。所有其他商標是它們各自所有者的財產。

消息來源：加利福尼亞微設備公司

聯繫方式：

加利福尼亞微設備公司理查·哈斯 (Richard Haas)

電話：+1-408-934-3108

電郵：richardh@cmd.com

網站：<http://www.cmd.com> (完)